

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	申万宏源证券 华安证券 中信建投基金 西藏信托 恒泰证券 九泰基金 衍航投资 招商信诺 长盛基金 天榕基金 浩鸿明凯投资 银杏资本 华夏基金 紫薇基金 长信基金 光大保德信
时间	2025年6月13日
地点	北京金融街威斯汀酒店及线上会议
接待人员	董事会秘书兼财务总监常亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司业绩有哪些结构性变化</p> <p>管理层较为关注2024年度业绩的如下结构性变化，这些变化趋势在2025年仍然持续：</p> <p>第一，公司主力业务大直径硅材料的毛利率已经恢复到约64个点，继续保持着领先的盈利能力；</p> <p>第二，公司成长型业务硅零部件占公司总营收的比重，已经达到了约40%，公司第二增长曲线已经确立，业绩稳定性增强；</p> <p>第三，公司的境内业务收入占主营收入的比重，已经达到了约70%，公司在中国半导体供应链国产化中取得了显著成绩。</p> <p>二、硅零部件业务的市场空间</p> <p>根据神工市场部调研，目前，中国大陆本土厂商的硅零部件市场需求约为25-30亿人民币/年，国产化率仅为10%左右；全球硅零部件市场需求约为15-20亿美元</p>

/年。

关于中国大陆市场。未来随着中国本土存储类集成电路制造厂商的产能和技术能力赶超世界一流水平，相应带动中国本土等离子刻蚀设备厂商的国产机台出货持续增加，并带动硅零部件作为关键耗材的需求；此外，随着中国本土近年集中新建的集成电路制造产线工艺日益稳定、工程师队伍日益成熟，其现存海外高端机台未来的硅零部件技改需求也会持续增加。

关于全球市场。随着全球科技巨头对算力相关高端存储芯片的持续巨额投资，在技术上要求更多的刻蚀次数和更大的产能，相应带动硅零部件的消耗及刻蚀设备的出货量增加。

因此，公司认为硅零部件市场的中长期需求增长可期。

三、半导体大尺寸硅片业务经营策略和市场预期

公司将继续争取获得主流芯片制造厂的认证通过及批量订单，延续去年行之有效的降本增效措施，不懈追求评估认证和经济效益的最佳平衡。公司还将积极发挥技术优势，深挖定制化潜力，拓展细分利基市场，形成差异化优势。

公司注意到：一方面，SEMI数据显示全球半导体硅片出货量在2024年第三季度恢复环比增长，但从第四季度开始环比增长幅度已连续两个季度持续下滑。公司认为，这反映了全球半导体产业的结构增长。另一方面，根据中国本土半导体硅片行业上市公司的公开信息，由于起步晚、技术积累有限，且受累于低迷的市场价格和较大的折旧压力，全行业经营压力普遍较大。

公司还注意到：在不利的市场环境下，半导体硅片产业也在因时而变。在8吋轻掺抛光硅片领域，具备全球竞争优势和寡头垄断地位的日本厂商，正在将更多产能调配至12吋轻掺抛光硅片，以在不额外增加资本开支的前提下，改善其盈利能力。

考虑到中国本土8吋轻掺硅片的潜在市场需求仍然存在增长，公司作为国内少数具备8吋轻掺抛光硅片技术和生产能力的企业，有望在行业供求关系的变动中，发挥自身独特技术优势，优化变动成本，改善竞争地位。

四、硅零部件业务的特点及进入壁垒

硅零部件是与硅片直接接触的刻蚀机核心工艺零部件。因此，其与金属结构件、陶瓷件等产品的技术难度不同，且具备更明显的“耗材”属性。

公司作为“从硅材料到硅零部件”一体化生产厂商，能够从材料和加工两个维度进行技术迭代，因此能够得到中国本土等离子刻蚀设备厂商的青睐，成为其重要合作伙伴；另一方面，公司凭借领先的技术实力，在国产半导体供应链中发挥了独特作用，具备一定先发优势。

五、硅零部件业务的盈利水平和扩产进度

宏观层面分析，根据产品生命周期理论，硅零部件产品在国际供应链处于“成熟期”；而在中国本土市场，该产品仍处于国产化进程中，属于“导入期”产品。公司作为少数具备“从硅材料到硅零部件”一体化生产能力的厂商，在硅零部件业务已深耕近十年，在中国本土半导体供应链安全建设中已经发挥了独特作用，因此率先将硅零部件业务从“导入期”发展至“成长期”，毛利率水平较高。

微观层面分析，硅零部件产品具有“品种多、批量小”的特点，具体产品消耗量依集成电路制造厂商的等离子刻蚀机种类、腔体结构、数量和具体制造工艺所决定，尺寸越大，设计要求越复杂的产品，对加工能力要求越高，毛利率相对越高。公司的产品线品类丰富，可以满足8吋和12吋主流等离子刻蚀机所需，因此战略上选择其中技术难度相对较大、国产化需求较紧迫、毛利率相对较高的硅零部件品类，因此毛利率水平较高。

关于硅零部件业务的扩产，公司认为需要考虑三个层面，即土地、设备和人员。土地方面，公司生产基地的设计产能较高，已于过去几年前瞻性预留厂房面积，因此空间充裕；设备方面，公司得到了下游供应商的长期稳健支持，交期、技术服务和响应速度都较为理想；人员方面，公司地处辽宁锦州，该地是中国最早的石英加工生产基地，还具备较为坚实的硅材料产业基础，拥有较为丰富的精通脆性材料加工工艺的产业工人资源。

公司认为：生产要素的整備是基础条件，“人机结合”更为关键，乃是一项系统工程。经过过去数年的连续扩产，该业务目前对公司的管理效率提出了更高要求乃至挑战。扩产的质量和扩产的速度需要保持最佳平衡，才能保障公司持续

	<p>健康发展。</p> <p>因此，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，努力确保目前行业领先的良率及毛利率水平，继续保持以高端产品为主的销售结构，满足中国本土硅零部件国产化的需求。</p> <p>六、半导体材料及零部件企业的外延式发展路径</p> <p>当前，中国半导体本土供应链建设进入“深水区”，零部件领域特别是上游材料领域的“硬骨头”已经水落石出，“卡脖子”风险凸显，本土集成电路制造厂和设备原厂的需求日益迫切。</p> <p>公司认为，迫切需求的背后是客户的超高预期：这些“硬骨头”处于关键工艺节点，对供应商对技术原理的理解和工艺积累的要求极高。一旦出现风险事件，客户方发生的损失巨大。因此，此类外延式发展对公司的研发能力和管理整合能力提出更高要求——“拿来主义”不可取，“跨界拼盘”风险大。</p> <p>管理层将基于自身在半导体硬脆材料领域的技术和经验积累，结合海外市场的资源和信息优势，通过拓展多种渠道和合作伙伴，巩固并扩展能力圈，积极稳妥地推动公司高质量发展。</p>
附件清单	无
日期	2025年6月17日